

天津德高化成新材料股份有限公司 与长春人造树脂厂股份有限公司达成战略业务合作的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

天津德高化成新材料股份有限公司(以下简称“公司、德高化成”)与长春人造树脂厂股份有限公司(以下简称“长春人造树脂厂”)于2025年12月就透明环氧树脂成型材(EVM)业务达成战略合作，本次合作的达成，标志着双方将整合技术、产能与市场资源，推动光半导体器件封装成型材市场产业集中和本地化客户服务能力升级。

二、本次合作主要内容

根据合作协议，德高化成将取得长春人造树脂厂旗下EVM业务相关的核心技术、生产设备、客户资源；长春人造树脂厂以成熟的产业链资源长期支持德高化成整合透明环氧树脂材料的生产、技术和市场服务。根据公司治理相关规则及《公司章程》等相关规定，本次业务合作涉及的交易对价无需提交董事会审议。

三、本次合作对公司的影响

德高化成深耕环氧树脂封装材料领域十余年，面向消费电子、通讯传感、精密显示等细分光半导体领域开发了TC-8020(通用型)、TC-8030/8040(中端可靠性)、TC-8060(高端白光应用)、TC-7600(精密显示)等系列化产品线，是透明环氧封装材料国产化的开拓先锋企业。长春人造树脂厂在透明环氧封装材料(EVM)业务，持续技术积累耕耘近二十年，形成了面向中高端应用的成熟产品线，包括EV-1012(指示灯通用型)、EV-1014(白光通用型)、EV-1016(白光高信赖型)、EV-1050EVB(红外传感器)等。长春人造树脂厂规模化生产能力强、产品质量稳定、客户关系持续性强。

作为电子信息产业的核心基础材料，透明环氧树脂成型材以其高效光波选择透过率、优良电绝缘性、优异的耐湿热稳定性及机械强度等特性，成为半导体芯片封装、光学器件制造等高端领域的关键支撑材料。当前，国内高端透明环氧树脂成型材市场国产化率不足 50%，光通讯、物联网传感器、精密显示等领域仍存在封装材料技术瓶颈，长期依赖国外品牌。此次业务整合有助于德高化成在相关领域改变市场分散竞争局面、扩充产品线丰度及客户资源、强化产能及产品交付能力、补充并优化原材料供应链。长春人造树脂厂将聚焦环氧树脂基础材料端的深度开发，通过与德高化成的长期技术合作架构，为应用端提供与时俱进的高品质原材料。双方合作实现优势互补。

四、 备查文件

（一）《EVM 營業暨財產讓與契約》

特此公告！

天津德高化成新材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 17 日